

技术参数

5708

日期：12/2023

应用

特点

单组份环氧树脂胶粘剂，流动性好，固化速度快，加热易返修，适用于 CSP/BGA & SMT 领域的底部填充，具有良好的锡膏兼容性

粘接材料

金属，陶器，玻璃，塑料

典型应用

CSP/BGA & SMT 底部填充

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	乳白色	
粘度(cps)	1284	20rpm@25℃, ASTM D-1084
固化条件*	10mins@120℃	
有效期@-20℃,月	6	

*固化温度是指达到胶水表面的实际温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	乳白	
邵氏硬度	70D	ASTM D-2240
玻璃化温度 Tg	57℃	DSC, TA Q20, 40℃/MIN
可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1%	
工作温度范围*	-55℃—150℃	

储存和使用方法

产品需低于-20℃环境中保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

注：

1. 本技术数据表(TDS)中提供的信息和应用建议是基于截至 TDS 更新日时，我们对本产品的了解和经验而编写，数据不作为质检标准。该产品可以有各种不同的应用，差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围，因此我们对产品的适用性不承担责任，强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试，并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本文档的内容可能会有更新，除非有明确的书面承诺，禧合没有义务通知用户关于内容的更改。

